

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零二一年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2021年5月13日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二一年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

### 二零二一年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 3.048 億美元，同比上升 50.3%，環比上升 8.8%。
- 毛利率 23.7%，同比上升 2.6 個百分點，環比下降 2.1 個百分點。
- 期內溢利 2,090 萬美元，上年同期為 270 萬美元，上季度為 2,820 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 3,310 萬美元，上年同期為 2,030 萬美元，上季度為 4,360 萬美元。
- 基本每股盈利 0.025 美元，上年同期為 0.016 美元，上季度為 0.034 美元。
- 淨資產收益率（年化）5.2%，同比上升 1.6 個百分點，環比下降 2.0 個百分點。

### 二零二一年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約 3.35 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 23%至 25%之間。

## 總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二一年第一季度業績評論道：

“華虹半導體在 2021 年第一季度取得了極其出色的成績。在全線產品的強勁需求推動下，尤其是 NOR flash、MCU、IGBT 和 CIS，營收達到 3.048 億美元，同比增長 50.3%，環比增長 8.8%，遠高於我們的收入指引和市場預期。毛利率為 23.7%，同比提高 2.6 個百分點，主要得益於產能利用率提高、產品組合優化和整體出貨價格上升；環比降低 2.1 個百分點，主要原因是公司在春節前對公司全體員工發放了獎金。本季度的淨利潤為 2,090 萬美元。”

“華虹無錫 12 吋廠取得了驚人的進展。貢獻銷售收入 5,460 萬美元，占總收入的 17.9%，較上季度增加了 53.1%。目前，無錫 12 吋廠的月產能已超 4 萬片，晶圓廠已滿負荷運轉。鑒於市場需求強勁，我們預計未來仍將滿載運營。也正因如此，我們從去年開始加速推進無錫 12 吋廠擴產計畫，預計今年年底月產能可達 6.5 萬片，並有望在 2022 年年中超過 8 萬片。基於以下幾點事實，管理團隊對公司的持續成長充滿信心：1) 我們的產能正在迅速擴大；2) 我們的研發團隊持續交付具有競爭力的技術平臺；以及 3) 全球半導體市場，尤其是中國半導體市場，將在未來數十年蓬勃發展。”

唐先生總結道：“華虹半導體一直將為全球半導體產業提供領先的特色工藝技術作為使命，並為之感到振奮自豪。當下正處在一個非常激動人心的時刻，我由衷地相信 2021 年對華虹半導體來說將是具有特殊意義的一年。這將是公司強勁成長的一年，我們整個團隊必將全力以赴，達成新的重要里程碑！”

## 電話會議公告

日期： 二零二一年五月十三日（星期四）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）  
上午 04:00（紐約，2021 年 5 月 13 日，星期四）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事  
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

[http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/upfrzavp>

(注：需要註冊才能訪問網絡直播)

電話詳細：	中國大陸	400 820 9615 或 800 820 7535
	中國香港	+852 3018 6768
	中國臺灣	+886 2 7703 1751
	新加坡	+65 6713 5521
	美國	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 5265449

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 [http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 網頁上，重複收聽會議。

## 關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有 8+12 英寸生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 4 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），“IC + Discrete”強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用。不僅是中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，亦為全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：[www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

**經營業績概要**  
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	304,843	202,854	280,094	50.3 %	8.8 %
銷售成本	(232,685)	(160,132)	(207,825)	45.3 %	12.0 %
<b>毛利</b>	<b>72,158</b>	<b>42,722</b>	<b>72,269</b>	<b>68.9 %</b>	<b>(0.2)%</b>
<b>毛利率</b>	<b>23.7 %</b>	<b>21.1 %</b>	<b>25.8 %</b>	<b>2.6</b>	<b>(2.1)</b>
經營開支	(59,502)	(71,462)	(61,134)	(16.7)%	(2.7)%
其他收入淨額	7,121	20,043	24,493	(64.5)%	(70.9)%
<b>稅前溢利</b>	<b>19,777</b>	<b>(8,697)</b>	<b>35,628</b>	<b>(327.4)%</b>	<b>(44.5)%</b>
所得稅收益/(開支)	1,148	11,442	(7,421)	(90.0)%	(115.5)%
<b>期內溢利</b>	<b>20,925</b>	<b>2,745</b>	<b>28,207</b>	<b>662.3 %</b>	<b>(25.8)%</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>6.9 %</b>	<b>1.4 %</b>	<b>10.1 %</b>	<b>5.5</b>	<b>(3.2)</b>
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	33,059	20,314	43,609	62.7 %	(24.2)%
非控股權益	(12,134)	(17,569)	(15,402)	(30.9)%	(21.2)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.025	0.016	0.034	56.3 %	(26.5)%
攤薄	0.025	0.016	0.033	56.3 %	(24.2)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	669	463	628	44.5 %	6.5 %
產能利用率 <sup>1</sup>	104.2 %	82.4 %	99.0 %	21.8	5.2
淨資產收益率 <sup>2</sup>	5.2 %	3.6 %	7.2 %	1.6	(2.0)

**二零二一年第一季度**

- 銷售收入再創歷史新高，達 3.048 億美元，同比上升 50.3%，主要得益於 CIS、MCU、分立器件產品的需求上升，環比上升 8.8%，主要得益於 NOR flash 及分立器件產品的需求上升。
- 銷售成本 2.327 億美元，同比上升 45.3%，環比上升 12.0%，主要由於晶圓銷售量、折舊及人工成本上升。
- 毛利率 23.7%，同比上升 2.6 個百分點，主要得益於產能利用率提升，產品組合優化及平均銷售價格上漲，環比下降 2.1 個百分點，主要由於折舊及人工成本上升，部分被產能利用率提升及平均銷售價格上漲所抵消。
- 經營開支 5,950 萬美元，同比下降 16.7%，主要由於研發費用減少，環比下降 2.7%。
- 其他收入淨額 710 萬美元，同比下降 64.5%，主要由於政府補貼及金融資產公允價值變動收益減少，環比下降 70.9%，主要由於本季度為外幣匯兌損失而上季度為外幣匯兌收益，及分佔聯營公司溢利減少。
- 所得稅收益 110 萬美元，上年同期為 1,140 萬美元，主要由於轉回以前年度計提的代扣代繳股息稅減少及應課稅利潤增加。
- 期內溢利 2,090 萬美元，上年同期為 270 萬美元，上季度為 2,820 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 3,310 萬美元，上年同期為 2,030 萬美元，上季度為 4,360 萬美元。
- 基本每股盈利 0.025 美元，上年同期為 0.016 美元，上季度為 0.034 美元。
- 淨資產收益率（年化）5.2%，同比上升 1.6 個百分點，環比下降 2.0 個百分點。

<sup>1</sup>產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup>母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績  
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
<b>華虹 8 吋</b>					
銷售收入	250,196	200,572	244,390	24.7 %	2.4 %
毛利	68,194	42,320	69,963	61.1 %	(2.5)%
毛利率	27.3 %	21.1 %	28.6 %	6.2	(1.3)
經營開支	(32,528)	(29,098)	(15,983)	11.8 %	103.5 %
稅前溢利	44,540	27,157	67,061	64.0 %	(33.6)%
息稅折舊及攤銷前利潤	82,883	60,036	98,193	38.1 %	(15.6)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	33.1 %	29.9 %	40.2 %	3.2	(7.1)
付運晶圓(8 吋仔片)	541	460	544	17.6 %	(0.6)%
<b>華虹無錫</b>					
銷售收入	54,647	2,282	35,704	2,294.7 %	53.1 %
毛利	3,964	402	2,306	886.1 %	71.9 %
毛利率	7.3 %	17.6 %	6.5 %	(10.3)	0.8
經營開支	(26,974)	(42,364)	(45,151)	(36.3)%	(40.3)%
稅前溢利	(24,763)	(35,854)	(31,433)	(30.9)%	(21.2)%
息稅折舊及攤銷前利潤	9,688	(22,800)	(4,426)	(142.5)%	(318.9)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	17.7 %	(999.1)%	(12.4)%	1,016.8	30.1
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	128	3	84	4,166.7 %	52.4 %

**華虹 8 吋**

- 銷售收入 2.502 億美元，同比上升 24.7%，環比上升 2.4%。
- 毛利率 27.3%，同比上升 6.2 個百分點，主要由平均銷售價格上漲，產能利用率提升及產品組合優化，環比下降 1.3 個百分點，主要由於人工成本上升，部分被平均銷售價格上漲所抵消。
- 經營開支 3,250 萬美元，同比上升 11.8%，主要由於折舊及人工費用增加，環比上升 103.5%，主要由於上一季度確認了若干項政府補助。
- 稅前溢利 4,450 萬美元，同比上升 64.0%，環比下降 33.6%。

**華虹無錫**

- 銷售收入 5,460 萬美元，上年同期為 230 萬美元，上季度為 3,570 萬美元。
- 經營開支 2,700 萬美元，同比下降 36.3%，環比下降 40.3%，主要由於研發費用減少，部分被確認的政府補助減少所抵消。
- 息稅折舊及攤銷前利潤首次實現利潤 970 萬美元。

### 銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	291,834	95.7 %	195,816	96.5%	96,018	49.0 %
其他	13,009	4.3 %	7,038	3.5%	5,971	84.8 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>304,843</b>	<b>100.0 %</b>	<b>202,854</b>	<b>100.0%</b>	<b>101,989</b>	<b>50.3 %</b>

- 本季度 95.7% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

### 銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	250,196	82.1 %	200,572	98.9%	49,624	24.7 %
12 吋晶圓	54,647	17.9 %	2,282	1.1%	52,365	2,294.7 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>304,843</b>	<b>100.0 %</b>	<b>202,854</b>	<b>100.0%</b>	<b>101,989</b>	<b>50.3 %</b>

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.502 億美元及 5,460 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二一年	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	同比
	第一季度	第一季度	第一季度	第一季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
中國 <sup>3</sup>	219,735	72.0 %	124,535	61.4%	95,200	76.4 %
亞洲 <sup>4</sup>	35,894	11.8 %	29,306	14.4%	6,588	22.5 %
美國	28,309	9.3 %	25,363	12.5%	2,946	11.6 %
歐洲	14,801	4.9 %	16,209	8.0%	(1,408)	(8.7)%
日本 <sup>5</sup>	6,104	2.0 %	7,441	3.7%	(1,337)	(18.0)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>304,843</b>	<b>100.0 %</b>	<b>202,854</b>	<b>100.0%</b>	<b>101,989</b>	<b>50.3 %</b>

- 本季度來自於中國的銷售收入 2.197 億美元，占銷售收入總額的 72.0%，同比增長 76.4%，主要得益於 CIS、MCU、IGBT、通用 MOSFET、NOR flash、超級結及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,590 萬美元，同比增長 22.5%，主要得益於 MCU、通用 MOSFET 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 2,830 萬美元，同比增長 11.6%，主要得益於其他電源管理、超級結及邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,480 萬美元，同比減少 8.7%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 610 萬美元，同比減少 18.0%，主要由於邏輯及超級結產品的需求減少。

<sup>3</sup>包括香港。

<sup>4</sup>不包括中國及日本。

<sup>5</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	94,506	31.0 %	73,360	36.2%	21,146	28.8 %
獨立非易失性存儲器	11,569	3.8 %	2,848	1.4%	8,721	306.2 %
分立器件	109,547	35.9 %	75,767	37.3%	33,780	44.6 %
邏輯及射頻	49,844	16.4 %	19,685	9.7%	30,159	153.2 %
模擬與電源管理	38,771	12.7 %	31,005	15.3%	7,766	25.0 %
其他	606	0.2 %	189	0.1%	417	220.6 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>304,843</b>	<b>100.0 %</b>	<b>202,854</b>	<b>100.0%</b>	<b>101,989</b>	<b>50.3 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 9,450 萬美元，同比增長 28.8%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 1,160 萬美元，同比增長 306.2%，主要得益於 NOR flash 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.095 億美元，同比增長 44.6%，主要得益於 IGBT、通用 MOSFET 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 4,980 萬美元，同比增長 153.2%，大部分得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,880 萬美元，同比增長 25.0%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。



### 銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	12,685	4.2 %	1,796	0.9 %	10,889	606.3 %
90nm 及 95nm	44,987	14.8 %	12,308	6.1 %	32,679	265.5 %
0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m	63,945	21.0 %	52,654	25.9 %	11,291	21.4 %
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	36,334	11.9 %	31,965	15.8 %	4,369	13.7 %
0.25 $\mu$ m	4,594	1.5 %	3,365	1.7 %	1,229	36.5 %
0.35 $\mu$ m 及以上	142,298	46.6 %	100,766	49.6 %	41,532	41.2 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>304,843</b>	<b>100.0 %</b>	<b>202,854</b>	<b>100.0 %</b>	<b>101,989</b>	<b>50.3 %</b>

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 1,270 萬美元，同比增長 606.3%，主要得益於 NOR flash 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 4,500 萬美元，同比增長 265.5%，主要得益於 CIS、智能卡芯片及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入銷售收入 6,390 萬美元，同比增長 21.4%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 3,630 萬美元，同比增長 13.7%，主要得益於其他電源管理及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 460 萬美元，同比增長 36.5%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.423 億美元，同比增長 41.2%，主要得益於 IGBT、通用 MOSFET、超級結、智能卡芯片及其他電源管理產品的需求增加。

### 銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二一年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第一季度 % (未經審核)	二零二零年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	189,038	62.0 %	125,393	61.8%	63,645	50.8 %
工業及汽車	59,998	19.7 %	50,088	24.7%	9,910	19.8 %
通訊	44,244	14.5 %	18,638	9.2%	25,606	137.4 %
計算機	11,563	3.8 %	8,735	4.3%	2,828	32.4 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>304,843</b>	<b>100.0 %</b>	<b>202,854</b>	<b>100.0%</b>	<b>101,989</b>	<b>50.3 %</b>

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.890 億美元，占銷售收入總額的 62.0%，同比增長 50.8%，主要得益於 MCU、通用 MOSFET、NOR flash、智能卡芯片、超級結及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 6,000 萬美元，同比增長 19.8%，主要得益於 IGBT 及通用 MOSFET 產品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求減少所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 4,420 萬美元，同比增長 137.4%，主要得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,160 萬美元，同比增長 32.4%，主要得益於通用 MOSFET 及 MCU 產品的需求上升。

### 產能<sup>6</sup>及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	28	10	20
<b>合計折合 8 吋產能</b>	<b>241</b>	<b>201</b>	<b>223</b>
產能利用率 (200mm)	104.3%	91.9%	104.4%
產能利用率 (300mm)	103.8%	6.9%	75.5%
總體產能利用率	104.2%	82.4%	99.0%

- 本季度末月產能達 241,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 104.2%，環比上升 5.2 個百分點。

<sup>6</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	環比
	第一季度 (未經審核)	第一季度 (未經審核)	第四季度 (未經審核)		
付運晶圓	669	463	628	44.5 %	6.5 %

- 本季度付運晶圓 669,000 片，同比增加 44.5%，環比增加 6.5%。

### 經營開支分析

以千美元計	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	環比
	第一季度 (未經審核)	第一季度 (未經審核)	第四季度 (未經審核)		
銷售及分銷費用	2,620	2,301	2,331	13.9 %	12.4 %
管理費用 <sup>7</sup>	56,882	69,161	58,803	(17.8)%	(3.3)%
<b>經營開支</b>	<b>59,502</b>	<b>71,462</b>	<b>61,134</b>	<b>(16.7)%</b>	<b>(2.7)%</b>

- 經營開支 5,950 萬美元，同比下降 16.7%，主要由於研發費用減少，環比下降 2.7%。

### 其他收入淨額

以千美元計	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	環比
	第一季度 (未經審核)	第一季度 (未經審核)	第四季度 (未經審核)		
租金收入	3,680	3,098	3,362	18.8 %	9.5 %
利息收入	3,037	2,710	2,604	12.1 %	16.6 %
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	-	3,454	-	(100.0)%	-
匯兌 (損失)/收益	(269)	1,352	11,583	(119.9)%	(102.3)%
分佔聯營公司溢利	1,512	2,896	12,803	(47.8)%	(88.2)%
財務費用	(1,636)	(317)	(1,771)	416.1 %	(7.6)%
政府補貼	544	6,607	(4,597)	(91.8)%	(111.8)%
其他	253	243	509	4.1 %	(50.3)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>7,121</b>	<b>20,043</b>	<b>24,493</b>	<b>(64.5)%</b>	<b>(70.9)%</b>

- 其他收入淨額 710 萬美元，同比下降 64.5%，主要由於政府補貼及金融資產公允價值變動收益減少，環比下降 70.9%，主要由於本季度為外幣匯兌損失而上季度為外幣匯兌收益，及分佔聯營公司溢利減少。

<sup>7</sup>管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

### 現金流量分析

以千美元計	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得/(用)現金流量淨額	60,831	(6,639)	84,492	(1,016.3)%	(28.0)%
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(167,528)	51,368	(223,167)	(426.1)%	(24.9)%
融資活動所得現金流量淨額	146,928	1,662	319,899	8,740.4 %	(54.1)%
外匯匯率變動影響淨額	(1,511)	(4,375)	25,103	(65.5)%	(106.0)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>38,720</b>	<b>42,016</b>	<b>206,327</b>	<b>(7.8)%</b>	<b>(81.2)%</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 6,080 萬美元，上年同期為所用現金流量淨額 660 萬美元，主要由於貿易應收項及應收票據的回收加快，及收到增值稅退稅款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.675 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 1.674 億美元，對一家聯營公司投資支出 140 萬美元，部分被利息收入 130 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 1.469 億美元，其中提取銀行借款 1.432 億美元，及發行股份收到 650 萬美元，部分被租賃負債支出 270 萬美元及支付銀行借款利息 10 萬美元所抵消。

### 資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)
資產總額	4,682,434	4,568,586
負債總額	1,326,917	1,214,465
所有者權益總額	3,355,517	3,354,121
資產負債率 <sup>8</sup>	28.3%	26.6%

### 資本開支

以千美元計	二零二一年 第一季度 (未經審核)	二零二零年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	24,275	32,858
華虹無錫	143,082	272,190
<b>合計</b>	<b>167,357</b>	<b>305,048</b>

- 本季度資本開支 1.674 億美元，其中 1.431 億美元用於華虹無錫。

<sup>8</sup> 資產負債率=負債總額/資產總額。

## 流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)
存貨	389,804	226,476
貿易應收款項及應收票據	127,613	120,952
預付款項、按金及其他應收款項	29,280	130,979
應收關聯方款項	7,220	4,706
已凍結存款及定期存款	356	359
現金及現金等價物	961,506	922,786
<b>流動資產總額</b>	<b>1,515,779</b>	<b>1,406,258</b>
貿易應付款項	124,799	130,980
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	346,232	386,305
計息銀行借款	90,959	47,784
租賃負債	1,884	4,235
政府補助	67,609	58,926
應付關聯方款項	23,469	12,647
應付所得稅	31,432	24,171
<b>流動負債總額</b>	<b>686,384</b>	<b>665,048</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>829,395</b>	<b>741,210</b>
速動比率	1.6x	1.8x
流動比率	2.2x	2.1x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	37	40
存貨周轉天數	99	93

- 存貨由上季度末的 2.265 億美元上升至本季度末的 3.898 億美元，主要由於購買一項土地使用權用於房地產開發及晶圓客戶需求增加。
- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1.310 億美元下降至本季度末的 2,930 萬美元，主要由於預付款的減少。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 3.863 億美元下降至本季度末的 3.462 億美元，主要由於應付資本性開支減少，部分被客戶預收款項增加所抵消。
- 計息銀行借款由上季度末的 4,780 萬美元上升至本季度末的 9,100 萬美元，主要由於本季度提取銀行借款。
- 政府補助由上季度末的 5,890 萬美元上升至本季度末的 6,760 萬美元，主要由於收到政府補助資金。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,260 萬美元上升至本季度末的 2,350 萬美元，主要由於收到關聯方的預付租金款。
- 淨營運資金本季度末 8.294 億美元，流動比率 2.2。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數由上季度的 40 天縮短至 37 天。
- 存貨周轉天數 99 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)
銷售收入	304,843	202,854	280,094
銷售成本	(232,685)	(160,132)	(207,825)
<b>毛利</b>	<b>72,158</b>	<b>42,722</b>	<b>72,269</b>
其他收入及收益	7,604	17,464	13,266
投資物業的公平值收益	-	-	198
銷售及分銷費用	(2,620)	(2,301)	(2,331)
管理費用	(56,882)	(69,161)	(58,803)
其他費用	(359)	-	(3)
財務費用	(1,636)	(317)	(1,771)
分佔聯營公司溢利	1,512	2,896	12,803
<b>稅前溢利</b>	<b>19,777</b>	<b>(8,697)</b>	<b>35,628</b>
所得稅收益/(開支)	1,148	11,442	(7,421)
<b>期內溢利</b>	<b>20,925</b>	<b>2,745</b>	<b>28,207</b>
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	33,059	20,314	43,609
非控股權益	(12,134)	(17,569)	(15,402)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.025	0.016	0.034
攤薄	0.025	0.016	0.033
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	<b>1,299,428,463</b>	<b>1,290,612,948</b>	<b>1,295,965,426</b>
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	<b>1,325,196,463</b>	<b>1,303,317,948</b>	<b>1,319,737,426</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二零年 (已審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	2,498,485	2,510,442	1,659,799
使用權資產	77,050	79,221	74,809
投資物業	179,202	180,476	166,023
無形資產	36,841	36,947	10,766
於聯營公司的投資	107,436	105,218	74,898
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	228,639	230,265	204,497
長期預付款項	29,447	10,768	14,721
應收關聯方款項	17	26	13,629
遞延稅項資產	9,538	8,965	7,313
<b>非流動資產總額</b>	<b>3,166,655</b>	<b>3,162,328</b>	<b>2,226,455</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	389,804	226,476	154,736
貿易應收款項及應收票據	127,613	120,952	156,223
預付款項、按金及其他應收款項	29,280	130,979	133,057
應收關聯方款項	7,220	4,706	10,593
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	-	-	270,167
已凍結存款及定期存款	356	359	70,765
現金及現金等價物	961,506	922,786	518,302
<b>流動資產總額</b>	<b>1,515,779</b>	<b>1,406,258</b>	<b>1,313,843</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	124,799	130,980	95,510
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	346,232	386,305	268,710
計息銀行借款	90,959	47,784	4,234
租賃負債	1,884	4,235	2,977
政府補助	67,609	58,926	40,017
應付關聯方款項	23,469	12,647	16,531
應付所得稅	31,432	24,171	31,431
<b>流動負債總額</b>	<b>686,384</b>	<b>665,048</b>	<b>459,410</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>829,395</b>	<b>741,210</b>	<b>854,433</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>3,996,050</b>	<b>3,903,538</b>	<b>3,080,888</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	618,261	518,391	21,171
租賃負債	16,689	17,405	15,837
遞延稅項負債	5,583	13,621	1,661
<b>非流動負債總額</b>	<b>640,533</b>	<b>549,417</b>	<b>38,669</b>
<b>淨資產</b>	<b>3,355,517</b>	<b>3,354,121</b>	<b>3,042,219</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,984,004	1,979,033	1,968,961
儲備	563,599	549,409	265,907
<b>本公司擁有人應佔權益</b>	<b>2,547,603</b>	<b>2,528,442</b>	<b>2,234,868</b>
非控股權益	807,914	825,679	807,351
<b>權益總額</b>	<b>3,355,517</b>	<b>3,354,121</b>	<b>3,042,219</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二零年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二零年 (未經審核)
	<b>經營活動所得/(用)現金流量：</b>		
稅前溢利	19,777	(8,697)	35,628
折舊及攤銷	71,158	45,616	56,368
應佔聯營公司溢利	(1,512)	(2,896)	(12,803)
營運資金的變動及其它	(28,592)	(40,662)	5,299
<b>經營活動所得/(用)現金流量淨額</b>	<b>60,831</b>	<b>(6,639)</b>	<b>84,492</b>
<b>投資活動所(用)/得現金流量：</b>			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(167,357)	(200,550)	(305,048)
投資聯營公司	(1,484)	-	-
收到政府對物業、廠房及設備的補助	-	-	80,136
其他投資活動所得現金流量	1,313	251,918	1,745
<b>投資活動所(用)/得現金流量淨額</b>	<b>(167,528)</b>	<b>51,368</b>	<b>(223,167)</b>
<b>融資活動所得現金流量：</b>			
提取銀行貸款	143,208	-	673,747
發行股份所得收益	6,498	3,817	602
償還銀行貸款	-	-	(352,299)
償還租賃負債	(2,709)	(2,078)	(524)
已付利息	(69)	(77)	(1,627)
<b>融資活動所得現金流量淨額</b>	<b>146,928</b>	<b>1,662</b>	<b>319,899</b>
現金及現金等價物增加淨額	40,231	46,391	181,224
外匯匯率變動影響淨額	(1,511)	(4,375)	25,103
期初現金及現金等價物	922,786	476,286	716,459
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>961,506</b>	<b>518,302</b>	<b>922,786</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事**

孫國棟

王靖

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二一年五月十三日